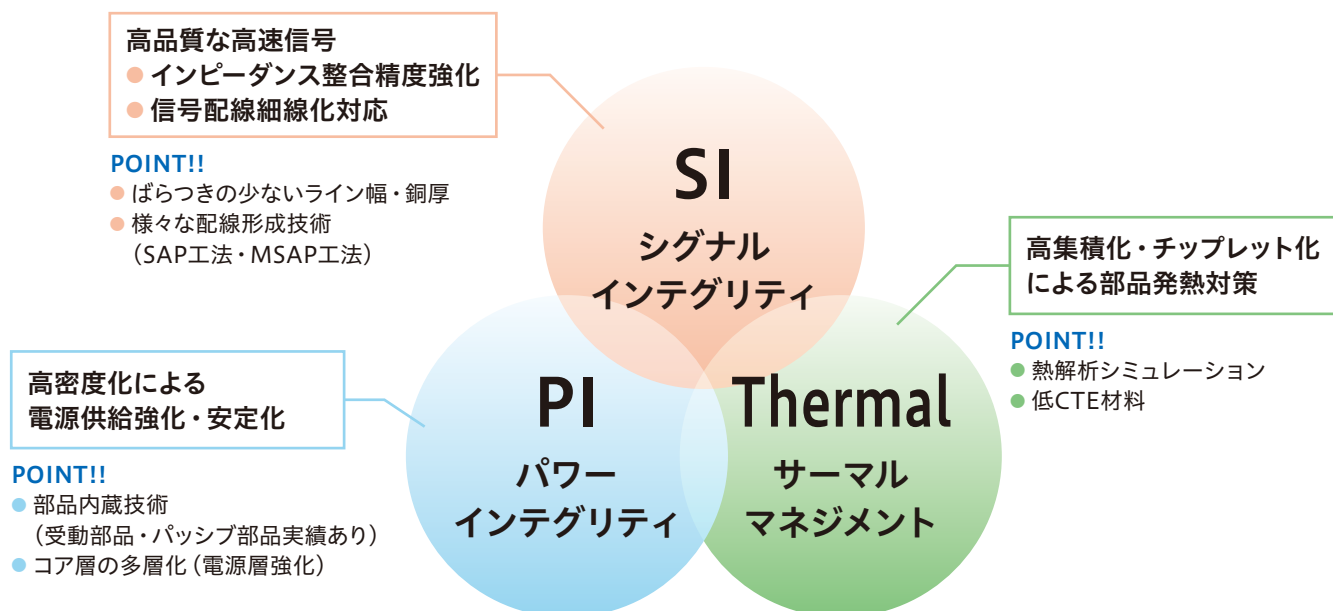


Substrate Feature ①

半導体パッケージの技術課題にソリューションを提供する工場



新規構造の提案

メイコー保有プロセスを組み合わせた様々な基板構造の実現が可能です！



狭ピッチはんだバンプ



細線パターン (MSAP、SAP)



DFSR



小径・狭ピッチPTH



低CTEコア



部品内蔵